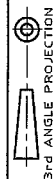


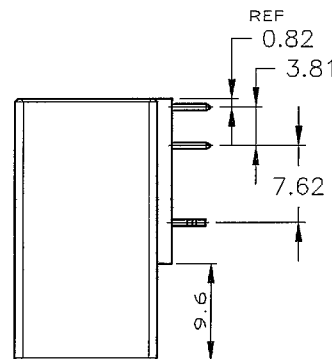
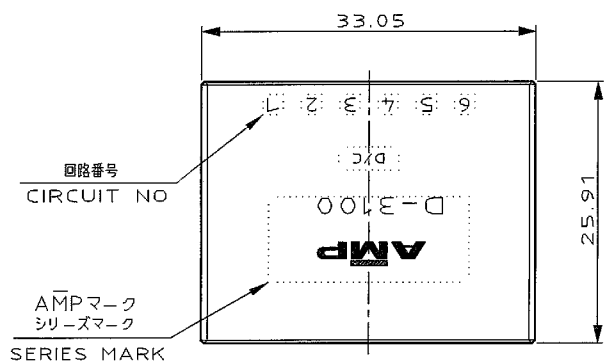
NUMBER 178306



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

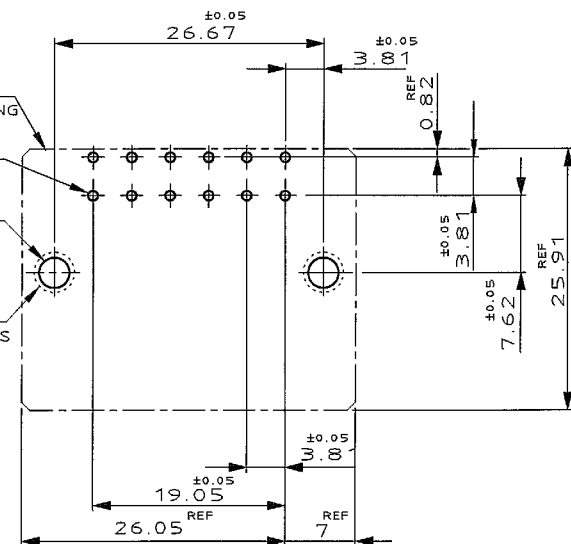
AMP-J
REV.10/83

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

12- ϕ 1.1
DIA 1.1 $\pm$ 0.1 12 PLACES

スルーホール 2- ϕ 3
DIA 3 $\pm$ 0.1 2 PLACES

ラウンド 2- ϕ 4 MIN
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES

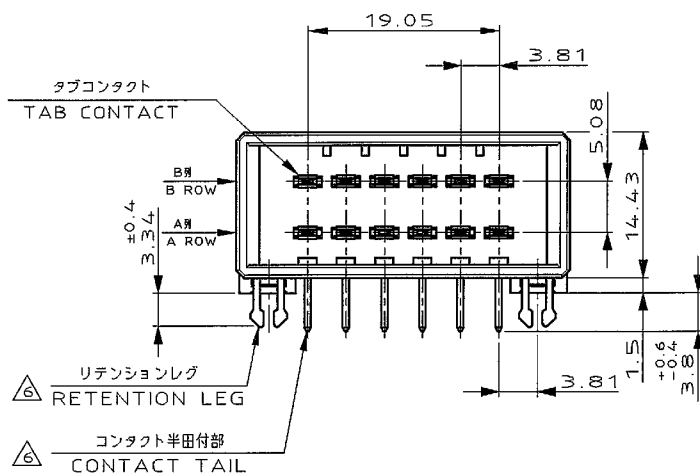


推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6 $\pm$ 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 $\pm$ 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO
PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μ M MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ M MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μ M MIN TIN
PLATED OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性

ポリエステル樹脂

コンタクト: 銅合金

リテンションレグ: 銅合金

めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 0.38 μ M MIN 金めっき

めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 0.76 μ M MIN 金めっき

めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 2.0 μ M MIN スズめっき

めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部

: ニッケル下地の土に半田めっき

めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部

: ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	SM	9/25/95
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	25 APR 95
O	RELEASED FJ00-2528-95	NM	Y.I	6/30/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
MATERIAL	FINISH	12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara	DE. 23 JUN 95 N. Matsubara	SIZE LOC NUMBER	C-178306
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA	APP. 3 JUL 95 S. MANABE	SCALE	REV. B
		SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面